

TECASINT 4121 black - División de semielaborados (barras, placas, tubos)

Designación química

PI (Poliimida)

Color

antracita

Densidad

1.53 g/cm³

Carga

15% grafito

Características principales

- muy elevada resistencia térmica y a la oxidación
- muy buenas propiedades de deslizamiento y al desgaste
- buena capacidad mecánica y térmica
- muy baja absorción de agua
- alta resistencia al creep
- buena resistencia química
- resistente contra alta radiación
- sensible a la hidrólisis en un amplio rango de temperaturas

Sectores estratégicos

- automoción
- tecnología de transporte
- tecnología vidrio caliente
- ingeniería mecánica
- ingeniería de precisión

Propiedades mecánicas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Resistencia a tracción	50 mm/min	93	MPa	DIN EN ISO 527-1	(1) eJ (2) eA
Módulo de elasticidad (ensayo a tracción)	1 mm/min	6600	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Elongación a rotura	50 mm/min	1.6	%	DIN EN ISO 527-1	
Resistencia a flexión	10 mm/min	113	MPa	DIN EN ISO 178	
Módulo de elasticidad (ensayo a flexión)	2 mm/min	6100	MPa	DIN EN ISO 178	
Elongación a rotura (ensayo a flexión)	10 mm/min	1.8	%	DIN EN ISO 178	
Resistencia a compresión	10 mm/min	200	MPa	EN ISO 604	
Resistencia a compresión	10mm/min, 10% strain	183	MPa	EN ISO 604	
Tensión a compresión a la rotura	10 mm/min	15	%	EN ISO 604	
Módulo de compresión	1 mm/min	2200	MPa	EN ISO 604	
Resistencia al impacto (Charpy)	max 7.5 J	11	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	1)
Resistencia al impacto entallado (Charpy)	max 7.5 J	1.4	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	2)
Dureza Shore	Shore D	87		DIN EN ISO 868	
Propiedades térmicas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Temperatura de transición vítrea		n.a.	°C	DIN EN ISO 11357	(1) Thermal expansion XY/Z axis
Expansión térmica (CLTE)	50-200°C	3.3 / 5.0	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	1) (2) Thermal expansion XY/Z axis
Expansión térmica (CLTE)	200-300°C	4.2 / 6.6	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	2) (3) Thermal expansion XY/Z axis
Expansión térmica (CLTE)	300-400°C	6.0 / 9.7	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	3)
Otras propiedades	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Absorción de agua	24 h in water, 23°C	0.08	%	DIN EN ISO 62	(1) Corresponding means no listing at UL (yellow card). The information might be taken from resin, stock shape or estimation. Individual testing regarding application conditions is mandatory.
Absorción de agua	24 h in water, 80°C	0.38	%	DIN EN ISO 62	
Resistencia a la llama (UL94)	corresponding to	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1)

Nuestra información y las declaraciones reflejan el estado actual de nuestros conocimientos acerca de nuestros productos y sus aplicaciones. No aseguran ni garantizan la resistencia química, calidad de los productos y su comercialización en forma jurídicamente vinculante. Nuestros productos no están diseñados para su uso en implantes médicos o dentales. Las patentes comerciales existentes han de ser respetadas. Los valores aportados en nuestras fichas técnicas son valores medios aproximados y sólo se pueden emplear para la comparación entre materiales. Estos valores están dentro del rango de tolerancia normal del producto y no representan los valores exactos de cada propiedad. Por lo tanto, no deben emplearse en aplicaciones con requisitos específicos. Desde Ensinger siempre recomendamos que se pruebe el material antes de utilizarlo en la aplicación. A menos que se indique lo contrario, estos valores están determinados a partir de materiales fabricados por extrusión y posteriormente mecanizados (normalmente barras de Ø40-60mm acorde con la DIN EN 15860). Como las propiedades dependen de las dimensiones del producto semielaborado y de la orientación de los componentes (especialmente los reforzados con fibra de vidrio, el material no puede utilizarse sin un ensayo aparte bajo circunstancias específicas. El cliente es el único responsable de la calidad e idoneidad de los productos para la aplicación y tiene que probar la viabilidad y procesamiento antes de su uso. Los valores de las fichas técnicas están sujetos a una revisión periódica, la actualización más reciente la encontrará en www.ensinger.es. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.